

Capacitación en Procesos de Manufactura de Semiconductores y Tecnologías de Empaquetado

Fecha: del 9 de julio al 5 de agosto de 2026

Fecha límite de inscripción: 5 de junio de 2026

Idioma de instrucción: Español



1

Introducción al Curso

Este programa presenta los fundamentos esenciales de la cadena de valor en semiconductores, abarcando diseño de circuitos integrados, procesos de fabricación y pruebas de encapsulado. Además, se realizarán simulaciones de circuitos y prácticas en la línea de producción, permitiendo a los participantes adquirir competencias clave desde la base del dispositivo hasta su aplicación final.

Enfoques del Curso

- **Semiconductores e Diseño de IC :** Fundamentos de los componentes, diseño IC con uso básico de LTspice y ejercicios de IC Layout.
- **Procesos de Fabricación y Empaquetado :** Introducción a procesos (oxidación, fotolitografía, etc.) y empaquetado; práctica con Silvaco y operación de línea de producción.
- **Visitas a la Cadena de Valor :** Recorridos en empresas clave para conocer la cadena de valor de semiconductores.

Contenido

- Mayores de 20 años, con formación en ingeniería eléctrica/electrónica o nociones de circuitos, interesados en semiconductores.

Persona de contacto del curso

Rachel Hsu

Tel: 886-2-28886090

Fax: 886-2-28766491

E-mail: L.y.hsu@icdf.org.tw

TaiwanICDF School



A Sneak Peek of
TaiwanICDF Workshop Program